

当前位置: 科技频道首页 >> 军民两用 >> 新材料与新工艺 >> 印刷电路板上倒扣封装技术研究



请输入查询关键词

科技频道

搜索

印刷电路板上倒扣封装技术研究

关键词: **封装 倒扣 集成电路技术**

所属年份: 2002

成果类型: 应用技术

所处阶段: 初期阶段

成果体现形式: 新工艺

知识产权形式:

项目合作方式: 其他

成果完成单位: 复旦大学

成果摘要:

倒扣芯片封装技术是目前国际上微电子封装技术研究中最热的热点之一, 本研究首先在已完成集成电路芯片制造的硅片上采用溅射方法制备UBM, UBM层的材料采用Ti/W-Cu系列。然后用电镀法电镀一层较厚的铜层, 以使凸缘在回流过程中能够保持一定的高度。最后电镀一层铅锡合金。经过回流工艺, 即在芯片上原来设计用于在引线键合的铝焊盘上形成一个铅锡合金的凸缘, 互连凸缘高度均匀性达到±5%, 可以直接贴装在印刷电路板(PCB板)上或进行芯片封装。

本成果还进行了倒扣芯片直接贴装在PCB上的可靠性研究, 经过专家鉴定认为, 其中的印刷电路板上倒扣封装技术研究在工艺制备、可靠性方面, 已达到国内先进, 接近国际先进水平。

成果完成人: 林晶;陈维孝;卢基纯;宗祥福;宋玲根;李越生;黄郁芳

[完整信息](#)

行业资讯

- 管道环氧粉末静电喷涂内涂层...
- 加氢处理新工艺生产抗析气变...
- 超级电容器电极用多孔炭材料...
- 丙烯酸酯共聚乳液水泥砂浆的...
- 库尔勒香梨排管式冷库节能技...
- 高温蒸汽管线反射膜保温技术...
- 应用SuperIV型塔盘、压缩机注...
- 非临氢重整异构化催化剂在清...
- 利用含钴尾渣生产电积钴新工艺
- 引进PTA生产线机械密封系统的...

成果交流

推荐成果

- [新型稀土功能材料](#) 04-23
- [低温风洞](#) 04-23
- [大型构件机器缝合复合材料的研制](#) 04-23
- [异型三维编织增减纱理论研究](#) 04-23
- [飞机炭刹车盘粘结修复技术研究](#) 04-23
- [直升飞机起动用高能量密封免维护...](#) 04-23
- [天津滨海国际机场预应力混凝土超...](#) 04-23

Google提供的广告

>> 信息发布

版权声明 | 关于我们 | 客户服务 | 联系我们 | 加盟合作 | 友情链接 | 站内导航

国科网科技频道 京ICP备12345678号